

Mate 2023

29th Symposium on "Microjoining and Assembly Technology in Electronics"

<mate 論文執筆要項>

① 論文体裁

(添付テンプレートをご利用下さい.)

○言語： 日本語または英語

○字体： 英語の字体（フォント）は Times が原則。
日本語の字体は明朝体とする（題目は除く）。

○題目： 本文が日本語の場合，日本語と英語 一段組
(字サイズ：14pt，字体：題目の字体はゴシック体)
※英文題目の各単語の先頭は，大文字とする（前置詞などは除く）。

○著者名・所属： 本文が日本語の場合，日本語と英語（字サイズ：9pt）

○Abstract： 英語(60～120 words) 一段組（字サイズ：9pt）

○キーワード：英語，各単語の先頭は大文字（字サイズ：9pt）

○本文： 日本語または英語 二段組(字サイズ：9pt，字体：明朝体)
一段 23～25 文字，一頁 47 行（46～49 行）

○マージン： 上 25mm，下左右 20mm

○用紙： A4 サイズ

○Figure および Table：必ず英語の caption を付けること。
また図表中の文字は全て英語表記とする。

○ページ制限： 4～6 ページ

○参考文献：必要な参考文献を下記書式に沿って記載ください。

(例)

- 1) 川戸祐一, 有村英俊, 工藤富雄, “フォトシタリングを利用した導電性銅ナノインクの焼結と Cu/ポリイミド界面の観察”, スマートプロセス学会誌, 2 (2013), pp.173-177.
- 2) P.S. James, H.W. Chandler, C.J. Newton, “The effect of mechanical loading on the contact resistance of coated aluminum”, A230 (1997), pp.194-201.
- 3) 梶原良一, 伊藤和利, 石居利明, “焼結 Ag 粒子ペーストを用いた鉛フリーパワー半導体パッケージの開発”, 第 16 回エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術シンポジウム論文集, 16(2010), pp.293-298.
- 4) C. Ehrhardt, M. Hutter, H. Oppermann, “Transient liquid phase soldering for lead-free joining of power modules in high temperature applications”, Proc. IMAPS International Conference and Exhibition on High Temperature Electronics, HiTEC 2012, Albuquerque, NM; United States; 8 May 2012-10 May 2012, pp.25-33.
- 5) 西岡利勝, 浜崎達也 編, プラスチック分析入門, 丸善, 2012, p.95.

○その他 :

- ・ pdf 版はカラーで問題ありませんが、印刷の仕上がりはモノクロ印刷です。
モノクロ印刷で容易に判別がつく図表を掲載ください。
- ・ 「新商品」や「新合金」などの論文にはふさわしくない表現は避け、再現性がある表現をしてください。